

全球半导体产业（重庆）博览会

导博会函 [2022]177 号

关于邀请参加 第四届全球半导体产业（重庆）博览会的函

汕头市人民政府：

由中国电子学会、中国汽车工业协会、重庆市经济和信息化委员会共同支持，重庆市电子学会、四川省电子学会、重庆市半导体行业协会、重庆市电源学会、重庆市电子电路制造行业协会联合主办，重庆市福祥会展服务有限公司承办的“第四届全球半导体产业（重庆）博览会”（以下简称：博览会）将于 2022 年 4 月 26 日-28 日在重庆国际博览中心举办。

博览会已经成功举办三届，现已成为中西部地区专业性强、规模层次高端的国际性半导体行业盛会，举办以来超过来自全球 20 个国家的 800 家知名企业参展、50000 名专业观众到现场参观交流。博览会汇聚了全球顶级的产品应用体验场景、产业链合作机遇、贸易商洽机会、招商推介、技术交流环境和品牌传播声量，达成的产业链合作、跨界整合、技术创新成效显著，是为参展品牌和合作伙伴全面赋能的行业重要活动。

第四届博览会将以“集智创芯、共塑未来”为主题，规划展出面积 25000 平方米，预计吸引 350 家知名企业参与，组织全国 100 个专业观众参观团，18000 名专业观众到场参观洽谈。博览会聚

焦半导体产业核心技术及发展趋势，拟设“电子信息产业基地、园区、IC设计、集成电路制造、封装测试、半导体材料、生产设备、电子元器件、AI+IOT+5G、智慧电源、微波毫米及射频技术、人才计划培训交流”等专业展区，同期将举办第四届未来半导体产业发展大会、招商引资推介会及签约仪式、智能汽车芯片论坛、智能手机芯片论坛、集成电路设计论坛、封装测试论坛、川渝半导体产业供需对接会等系列活动，深度解构半导体领域发展热点难点，联动政、产、学、研、用界全面探讨合作新机遇，发展新动能。

在此，新一届博览会筹备工作全面启动之际，特邀请汕头市参加2022年博览会。利用本次博览会契机，积极展示产业发展成果，进一步帮助辖区企业拓展应用市场，扩大经贸往来及技术合作，加强招商引资和产业项目推介，让更多行业巨头落户辖区，助推“成渝双城经济圈电子信息产业协同发展”，共享博览会平台机遇。

特此邀请！

（组委会联系人：刘名洋 19866136627 023-61212182）

全球半导体产业（重庆）博览会

2022年11月11日

附件1：第四届博览会及会议概况

2：组织机构文件

3：参展意向收集表

附件 1：第四届博览会及会议概况

第四届全球半导体产业（重庆）博览会

一、基本概况

时间：2022 年 4 月 26 日-28 日

地点：重庆国际博览中心

主题：集智创“芯” 共塑未来

规模：25000 展出面积（m²）

展商：350+知名企业（家）

观众：18000+专业观众（名）

二、组织机构(排名不分前后)

支持单位：中国电子学会

中国汽车工业协会

重庆市经济和信息化委员会

主办单位：重庆市电子学会

四川省电子学会

重庆市半导体行业协会

重庆市电源学会

重庆市电子电路制造行业协会

协办单位：重庆市机器人与智能装备产业联合会

重庆市集成电路技术创新战略联盟

集成电路特色工艺及封装测试联盟

重庆市电子产业技术创新战略联盟

浙江省半导体行业协会

陕西省半导体行业协会

天津市集成电路行业协会

四川省电源学会

深圳市电子行业协会

成都市集成电路行业协会

深圳市电子商会

成都市电子信息行业协会

深圳市半导体行业协会

川渝电子信息产业联盟

承办单位：重庆市福祥会展服务有限公司

三、上届回顾

博览会得到了重庆市政府和中国电子学会高度关注和重视，重庆市原市长唐良智、市经信委原副主任刘忠莅临现场观摩指导，分别了解参展企业发展情况、客户群体及发展战略。唐市长给予展会专业化平台认可，并期望继续整合产业资源，汇聚更多国内外半导体巨头企业不断强链补链，共建生态产业体系。

上届展会汇聚了 ABB、西门子、罗姆、高通、万国（AOS）、

平伟实业、雅讯、赛宝、同辉气体、赛迪研究院、杭州中欣晶圆、湖南国芯、摩尔元数、重庆西部电子电路产业园、东湖高新、上海临港新区、广东大湾区集成电路产业研究院、先导集团、海康威视、成都市青羊、大族激光、森美协尔、鲲鹏、广州广钢、恒格微、伊欧陆、概伦、晶辉半导体、富美达、中科格励微、聚能创芯、光舵微纳、时创意、泰晶科技、惠伦晶体、中科芯、大华无线、东方中科、舜宇光学、卡尔蔡司、惠伦晶体、泰晶、中国自动化研究院、芯启源等 280 家行业知名企业参展,展示面积 18000 平方米,展会三天,吸引了共计 13500 人专业观众参观交流。博览会期间举办了“第三届未来半导体产业发展大会”,主会场与集成电路、AI+5G+IOT、创新材料、汽车芯片等多场专题论坛。汇聚了院士、专家、协(学)会领导、企业高层、科研院所、产业园区及媒体界专家等 1000 余名专业人士参会互动。

四、展览范围

(一) 政府、产业园专区:电子信息产业、集成电路、半导体产业领域高科技产业园区等;

(二) IC 设计专区:嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混号讯号电路设计、集成电路布局设计等;

(三) 封装测试专区:测试探针台、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝等;

(四) 半导体材料专区:硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、

光刻胶及其配套试剂、CMP 抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料等；

（五）设备制造专区：减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD 设备、清洗设备、切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台、洁净室设备等；

（六）电子元器件专区：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶（带）制品、电子化学材料及部品等；

（七）AI+5G 专区：工业互联网平台、智能机器人、智能汽车、智能手机、智能交通、航天航空电子、智能家电、无人机、5G 开发及应用、多接入边缘计算、网络切片、虚拟技术、医疗电子等；

（八）智慧电源专区：微波射频、半导体 LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等。

第四届未来半导体产业发展大会

一、大会背景

随着中国经济稳健增长，在 5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联汽车等新型应用的驱动下，各类芯片需求呈现高速增长态势，进一步加速半导体产业链供应链重构。国家 2030 规划和“十四五”国家研发计划明确第三代半导体是重要发展方向，加速实现产业链的国产替代，成为我国半导体产业升级必经之路，重庆提出优化完善“芯、屏、器、核、网”全产业链。

为深入推动成渝双城经济圈建设，打造内陆开放战略高地，助力重庆半导体产业升级发展，重庆市经济和信息化委员会、中国电子学会、中国汽车工业协会将共同支持举办第四届未来半导体产业发展大会。

二、活动概况

时间：2022 年 4 月 26-27 日

地点：重庆国际博览中心

主题：集智创芯 共塑未来

嘉宾：100 人

观众：1500-2000 人

三、日程安排

日期	会议内容
4月中旬	博览会新闻发布会
4月26日	开幕式及领导巡馆
	主论坛
	招商推介会及签约仪式
	川渝半导体产业投资对接会
	重庆市电子学会换届大会
	集成电路设计论坛
4月27日	封装测试论坛
	智能汽车、手机芯片论坛
	高性能电源&电动车技术发展论坛

四、主题论坛

（一）未来半导体产业发展大会（主论坛）

在国家大力支持半导体产业发展的大背景下，未来中国半导体产业发展趋势如何？本次论坛聚焦半导体行业关键技术热点疑难，邀请国内外半导体顶流大咖，与行业龙头、科研院校及媒体界专家及代表深度洞悉政策风向、行业动态，准确把握未来半导体产业发展方向与创新策略。

- “十四五”半导体产业发展趋势及应对策略
- 品牌自主创新的机遇与挑战

- AI 芯片疑难及解决方案
- 国产半导体产业现状及未来发展路线
- 5G 发展推动半导体行业革新

【拟邀分享单位】中国工程院院士倪光南、中国工程院院士沈昌祥、中国科学院院士郝跃、中国电子学会、北京大学、中芯国际、赛迪研究院

（二）集成电路设计论坛

在智能互联时代，以集成电路产业为基础的 5G、物联网、AI 等前沿先进技术快速发展，成为拉动国家经济发展、增强国家综合国力的核心力量。本次论坛针对国内集成电路领域发展现状，结合领域内前沿技术与工艺，邀请行业杰出代表为我国集成电路产业的创新发展献计献策。

- 集成电路产业现状与竞争格局分析
- 人工智能时代 EDA 解决方案
- 物性故障分析系统提升芯片生产良率
- IC 产业创新生态应用
- 芯片异构集成技术助力芯片产业

【拟邀分享企业】中国集成电路产业技术创新联盟、华大九天、卡尔蔡司中国、ADI 中国、英特尔

（三）先进封装测试论坛

随着新型应用对高效节能芯片的要求越来越强烈，半导体业

界正在积极寻求封装测试技术解决方案。本次论坛聚焦封测试领域，探索和布局先进封装、异构集成的创新技术、发展方向、产业生态及行业发展机遇。

- 先进封测产业新布局
- 开启新时代先进封装技术引擎
- 晶圆制造封测设备国产化
- 先进封装工艺设计
- 先进封测 5G 产品应用及挑战

【拟邀分享企业】 华天科技、华润微电子、华峰测控、联合微电子、长电科技股份有限公司

（四）智能汽车芯片论坛

芯片在汽车领域发挥着不可或缺的作用，无论是自动驾驶芯片、通信基带芯片还是智能座舱芯片，都直接决定着汽车的智能化水平。车用芯片种类众多、层次分化、规模巨大，“缺芯”困扰下的车企，如何加强产业自主研发实现芯片自由？行业大咖将结合产业现状解析痛点、献策化解“芯”荒，寻求中国汽车半导体产业新机遇。

- 半导体 IP 引领汽车“新四化”突破方案
- 全新一代车规级 MCU 进阶路线
- 车载 AI 芯片技术趋势
- 高端新能源汽车芯片自主设计战略

- 智能网联汽车芯片技术突破

【拟邀分享企业】中国汽车工业协会、长安汽车、比亚迪半导体、金康、奇瑞汽车

（五）智能手机芯片论坛

芯片作为智能手机“皇冠上的明珠”，一直是智能手机中最难攻克的技术之一，智能手机芯片市场竞争日趋激烈。本主题论坛汇聚国内智能手机及智能终端设备与技术领先企业，产业链合作伙伴、行业专家、学者、政策制定者、投资机构代表、媒体和分析师，共同探讨智能手机芯片自研崛起创新之路。

- 智能手机芯片升级方案
- 异构计算架构创新
- 5G 应用高性能芯片安全
- 智能手机 SOC 创新突破
- 超智能手机平台技术创新与产业应用

【拟邀分享企业】华为、华夏芯、小米、高通、百度飞桨、OPPO、vivo、传音、华硕、一加、百立丰、360 等。

（六）川渝半导体产业投资对接会

为积极助推“成渝地区双城经济圈建设”，加强成渝两地半导体产业协同发展。本次活动积极搭建成渝两地产业互动交流与合作平台，做好政府与企业、高校院所间的桥梁和纽带，聚集政产学研用等多方要素，助推两地科研院校的创新资源与产业企业

精准对接，为成渝半导体产业高质量发展做有力支撑。

【活动环节】签约仪式、成果展示、园区推介、签约合作、洽谈交流、技术研讨

五、部分拟邀参会嘉宾（排名不分先后）

沈昌祥·中国工程院院士

倪光南·中国工程院院士

郝 跃·中国科学院院士

姚杰·中国汽车工业协会专务副秘书长

滕冉·赛迪研究院集成电路中心负责人

金玉丰·北京大学教授

余 华·重庆大学教授

李世彬·电子科技大学光学工程学院

雒江涛·重庆邮电大学电子信息与网络工程研究院副院长

李 虹·华润微电子董事、首席运营官博士

刘嵘侃·联合微电子中心有限责任公司副总经理

陈大同·展讯通信（上海）有限公司首席技术官

谢志峰·上海矽睿科技有限公司创始人

丁险峰·阿里云首席物联网科学家

李汝冠·广州广电计量检测股份有限公司半导体技术副总监

罗海辉·株洲中车时代半导体有限公司常务副总经理

邓世友·紫光云 CTO 办公室主任

安侠睿·北京首创高科技发展有限公司副总经理

徐骅·西南集成电路设计有限公司副总经理

陈佳延·雅特力科技(重庆)有限公司业务处长

彭进·中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁

熊巍·西门子智能基础设施集团数字电网事业部战略总监

林其峰·ROHM 深圳技术中心副经理

徐皓·高通中国区研发负责人

陈刚·比亚迪半导体有限公司总经理

高继勇·金康科技中心电子电器智能驾驶总监

何举刚·长安汽车智能化研究院总经理

刘伟平·北京华大九天科技股份有限公司董事长

仲小龙·英飞凌大中华区汽车电子事业部高级总监

龚小平·MathWorks 高级应用工程师

陈子龄·杭州中欣晶圆半导体股份有限公司应用技术部长

陶毅君·海康威视电子制造行业负责人

鲍海森·上海海思技术有限公司战略规划部总监

六、部分拟邀参会单位

邀请单位有：华润微电子、联合微电子、通富微电子、华天科技、长电科技、中科芯集成电路、潮州三环、安靠科技、中科飞测、中芯国际、日月光集团、环旭电子、紫光展锐、上汽集团、北方华创、东微半导体、ASM、京东方、中星微、中国中车、有

研半导体、先导集团、长安集团、长晶科技、长城汽车、比亚迪汽车、蔚来汽车、大陆汽车、博郡汽车、重庆邮电大学、罗姆、万国、SK、NXP、TI、ST、ADI、华大半导体、华大九天、synopsys、Cadence、高通、Mentor、Toshiba、华登国际、地平线等国内知名单位。

七、参会对象

（一）政府相关部门、半导体行业相关协（学）会、科研院所

（二）企业高层领导及技术负责人

- EDA、IP 设计、制造、材料、设备等上游支撑企业；
 - 集成电路、封装测试、整机厂商、分立器件、光电子、传感器等中端制造企业；
 - 通信及智能手机、PC、汽车、大数据、互联网、AI、5G 开发及应用、物联网、笔电、医疗、光通讯/光模块、航天航空电子、军工制造、轨道交通、智能交通、智能家电、智能穿戴、智能汽车、智能工厂、智能楼宇、仪器仪表、无人机、印刷电路板制造、安全测试、SMT、3C 自动化，3D 打印、平板显示等终端应用企）。
- （三）主流媒体及专业媒体等。

八、相关流程及注意事项

（一）参展流程

1. 确定展团牵头单位和具体负责处室，并将联络人信息反馈至组委会；
2. 与组委会沟通确定参展方案，包括展台面积、具体位置、广告方案、费用情况、会议论坛等；
3. 填报参展报名表，完成参展确认程序；
4. 根据组委会提供的《参展指南》，落实展台装修方案、行程安排、资料报送、交通住宿等工作。

（二）收费标准及展位安排

1. 展位收费标准为：省市展团统一按照1200元/m²执行。
2. 展位安排原则是先报名、先确认、先安排。
3. 广告收费与会议赞助等，将提供详细的赞助合作方案，如有需要请联系组委会索取。

（三）注意事项：由于各省市展团较多，请各展团将牵头组织单位及具体联络人信息尽快反馈至组委会，以便于落实各项细节。

附件 2：组织机构文件

中国电子学会

关于同意作为全球半导体产业（重庆）博览会支持 单位的复函

重庆市电子学会：

你会《关于恳请中国电子学会继续作为全球半导体产业（重庆）博览会支持单位的请示》收悉。经研究，我会同意作为第四届全球半导体产业（重庆）博览会支持单位。希望以全球半导体产业（重庆）博览会作为重要载体，共同推进重庆“芯屏器核网”全产业链发展，为国家半导体行业创新高质量发展贡献力量。请贵会做好博览会的筹备组织实施工作。

特此函复。



重庆市经济和信息化委员会

重庆市经济和信息化委员会 关于同意作为第四届全球半导体产业（重庆） 博览会支持单位的复函

重庆市福祥会展服务有限公司：

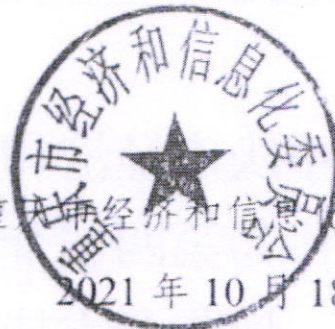
你公司《关于恳请作为第四届全球半导体产业（重庆）博览会支持单位的请示》已收悉。经研究，我委同意作为第四届全球半导体产业（重庆）博览会支持单位。现就有关事项函复如下：

一、按照“谁主办、谁负责”的原则，你公司要“谨终如始”加强常态化疫情防控，抓实抓细疫情防控应急预案的各项措施，确保每一个点位、每一项措施、每一个流程都要精准精细，切实提升快速处置、精准防控的能力，有效降低聚集性感染风险。

二、鉴于参展企业数量越来越多，你公司要充分认识知识产权保护工作的重要性，认真做好知识产权保护和安全防范工作。

三、鉴于展会的影响力越来越大，如有台湾、港澳以及国外主体参加活动，须按程序报经市台办和市政府外事办公室同意。

此复。



重庆市经济和信息化委员会

2021年10月18日

(联系人：周秋宇；18883513008)

重 庆 市 电 子 学 会 四 川 省 电 子 学 会 重 庆 市 半 导 体 行 业 协 会 重 庆 市 电 源 学 会

渝导博联文[2021]1 号

关于邀请参加 第四届全球半导体产业（重庆）博览会的通知

各会员单位及相关企业：

由中国电子学会、中国汽车工业协会、重庆市经济和信息化委员会共同支持，重庆市电子学会、四川省电子学会、重庆市半导体行业协会、重庆市电源学会联合主办，重庆市福祥会展服务有限公司、重庆市电子学会 SMT/MPT 专委会承办的“第四届全球半导体产业（重庆）博览会”将于 2022 年 4 月 26 日-28 日在重庆国际博览中心举办。

全球半导体产业（重庆）博览会举办目的是为我国大力发展集成电路产业，促进重庆“芯屏器核网”及西部半导体产业快速成长，推进成渝双城经济圈协作发展。此博览会在重庆成功举办三届，现已成为中西部地区专业国际半导体行业盛会。

博览会将以“集智创芯、共塑未来”为主题，规划展出面积 25000 平方米，预计吸引 350 家知名企业参与，18000 名专业观众到场参观洽谈。展会聚焦半导体产业核心技术及发展趋势，拟设“IC 设计、集成电路制造、封装测试、半导体材料、生产设备、电子元器件、AI+IOT+5G、智慧电源、微波毫米及射频技术、人才计划培训交流”等专区，为半导体产业链上中下游企业搭建前沿展览、技术研讨、洽谈合作的生态交流平台。同期将举办第四届未来半导体产业发展大会，深度解构半导体领域发展热点疑点，联动官、产、学、研界全面探讨产业突围路径与发展新机遇。

在此博览会筹备之际，我们诚邀贵单位（企业）携新技术、新产品参展参会，提升品牌知名度，扩大行业影响力，共谋西部半导体产业创新发展。

特此邀请！关于博览会详细信息，请与组委会联系。

联系人：韩振江 15111999807



重庆市电子电路制造行业协会

关于邀请参加

第四届全球半导体产业（重庆）博览会的通知

各会员单位及相关企业：

由中国电子学会、中国汽车工业协会、重庆市经济和信息化委员会共同支持，重庆市电子学会、四川省电子学会、重庆市半导体行业协会、重庆市电源学会、重庆市电子电路制造行业协会联合主办，重庆市福祥会展服务有限公司、重庆市电子学会SMT/MPT专业委员会承办的“第四届全球半导体产业（重庆）博览会”将于2022年4月26日-28日在重庆国际博览中心举办。

全球半导体产业（重庆）博览会举办目的是为我国大力发展集成电路产业，促进重庆“芯屏器核网”及西部半导体产业快速成长，推进成渝双城经济圈协作发展。此博览会在重庆成功举办三届，现已成为中西部地区专业国际半导体行业盛会。

博览会将以“集智创芯、共塑未来”为主题，规划展出面积25000平方米，预计吸引350家知名企业参与，18000名专业观众到场参观洽谈。展会聚焦半导体产业核心技术及发展趋势，拟设“IC设计、集成电路制造、封装测试、半导体材料、生产设备、电子元器件、AI+IOT+5G、智慧电源、微波毫米及射频技术、人才计划培训交流”等专区，为半导体产业链上中下游企业搭建

前沿展览、技术研讨、洽谈合作的生态交流平台。同期将举办第四届未来半导体产业发展大会，深度解构半导体领域发展热点疑点，联动官、产、学、研界全面探讨产业突围路径与发展新机遇。

上届展会汇聚了 ABB 中国、AOS、海康威视、中欣晶圆、大湾区集成电路产业研究院、赛迪研究院、上海临港、平伟实业、时创意、鲲鹏信息等 280 家行业知名企业参展，展示面积 18000 平方米，展会三天，吸引了共计 13500 人专业观众参观交流。展会期间隆重举办了“第三届未来半导体产业发展大会”，设置主会场与集成电路、AI+5G+IOT、创新材料、汽车芯片等多场专题论坛。汇聚了产业园区、协会领导、企业高层、科研院校及媒体界专家等 1000 余名专业人士参会互动。

在此博览会筹备之际，我们诚邀贵单位（企业）携新技术、新产品参展参会，提升品牌知名度，扩大行业影响力，共谋西部半导体产业创新发展。

特此邀请！关于博览会详细信息，请与组委会联系。

联系人：韩振江 15111999807



四川省电源学会关于同意作为全球半导体产业（重庆）博览会协办单位的复函

全球半导体产业（重庆）博览会组委会：

你会“关于邀请四川省电源学会作为全球半导体产业（重庆）博览会协办单位的请示”已收悉。经研究，我会同意作为 2022 年 4 月 26 日-28 日在重庆国际博览中心举办的第四届全球半导体产业（重庆）博览会协办单位。我会将通知会员企业积极参展、参会。

特此复函



成都市集成电路行业协会

Chengdu Integrated Circuit Industry Association

关于同意作为全球半导体产业（重庆）博览会 协办单位的复函

全球半导体产业（重庆）博览会组委会：

你会“关于邀请成都市集成电路行业协会作为全球半导体产业（重庆）博览会协办单位的请示”已收悉。经研究，我协会同意作为2022年4月26日-28日在重庆国际博览中心举办的第四届全球半导体产业（重庆）博览会协办单位。我会将发文通知会员企业积极参展、参会；由协会林美娇作为本次活动联络人。

特此复函

联系人：林美娇

黄春霞（组委会）18225329041

成都市集成电路行业协会
2021年10月14日



津集协字【2021】004号

关于同意作为全球半导体产业（重庆）博览会 协办单位的复函

全球半导体产业（重庆）博览会组委会：

你会“关于邀请天津市集成电路行业协会作为全球半导体产业（重庆）博览会协办单位的请示”已收悉。经研究，我协会同意作为2022年4月26日-28日在重庆国际博览中心举办的第四届全球半导体产业（重庆）博览会协办单位。我会将发文通知会员企业积极参展、参会；由协会王瑞霞作为本次活动联络人。

特此复函

联系人：王瑞霞（天津市集成电路行业协会）

黄春霞（组委会）18225329041



陕西省半导体行业协会

关于同意作为全球半导体产业（重庆）博览会 协办单位的复函

全球半导体产业（重庆）博览会组委会：

你会“关于邀请陕西省半导体行业协会作为全球半导体产业（重庆）博览会协办单位的请示”已收悉。经研究，我协会同意作为2022年4月26日-28日在重庆国际博览中心举办的第四届全球半导体产业（重庆）博览会协办单位。我会将发文通知会员企业积极参展、参会；由协会高引雷作为本次活动联络人。

特此复函

联系人：高引雷（秘书长助理）



陕西省半导体行业协会

2021年9月29日

成都市电子信息行业协会

成电协【2021】23号

关于同意作为全球半导体产业（重庆）博览会 协办单位的复函

全球半导体产业（重庆）博览会组委会：

你会“关于邀请成都市电子信息行业协会作为全球半导体产业（重庆）博览会协办单位的请示”已收悉。经研究，我协会同意作为2022年4月26日-28日在重庆国际博览中心举办的第四届全球半导体产业（重庆）博览会协办单位。我会将发文通知会员企业积极参展、参会；由协会沈曦作为本次活动联络人。

特此复函

联系人：沈曦 成都市电子信息行业协会



附件 3：参展意向收集表

单位					
地址				邮编	
联系人		职务		邮箱	
电话		手机		传真	
意向活动	展示面积：空地_____平方米，标展_____个 广告 ☐ 论坛演讲 ☐ 礼品其他 ☐				
预算总额					
感谢您支持和关注,为了精准地了解和帮助贵单位,请告诉我们您的需求。烦请将此表回执到至 3259360786@qq.com					

联系我们

联系人：刘名洋 19866136627（微信同号）

邮箱：3259360786@qq.com

网址：www.gsiqcq.com